

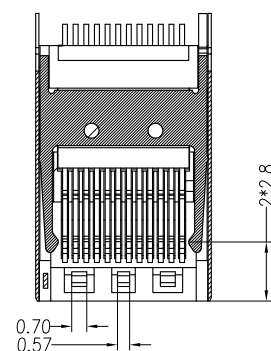
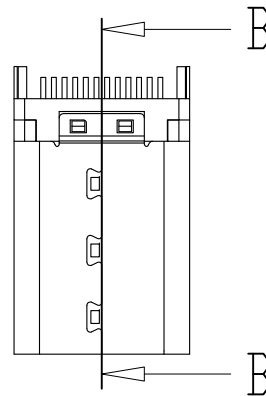
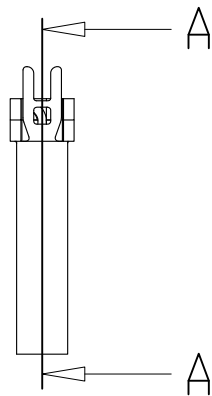
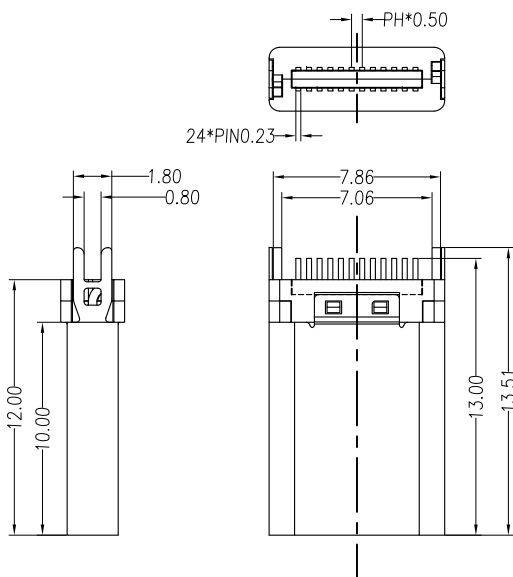
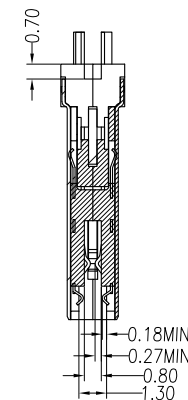
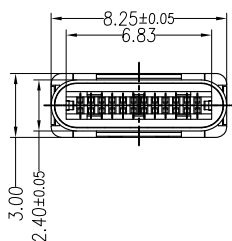
RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

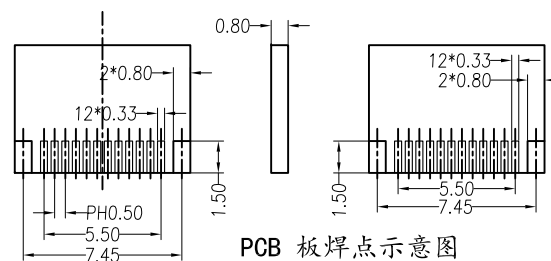
剖面 A-A
比例 1 : 1剖面 B-B
比例 1 : 1

材料:Material:

1. 塑胶: Housing: Hing Temperature Thermoplastics, LCP 耐高温塑胶
2. 端子: Contact: Copper Alloy 磷铜
3. 外壳: Shell: Copper Alloy 不锈钢
4. 卡钩: Shell: Copper Alloy 不锈钢
5. 弹片: Shell: Copper Alloy 不锈钢

电镀:Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Tails
接触点镀金, 焊脚镀锡。
电镀类型: 1U"、3U"、15U"、30U"



PCB 板焊点示意图

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X.	±5°
.X	±0.25	.X	±2°
.XX	±0.20	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-118A2021Y40005
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1公头冲压款立式10.0 12.0夹板0.8 LCP 黑胶 24PIN
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	 版本 VER
					A0